
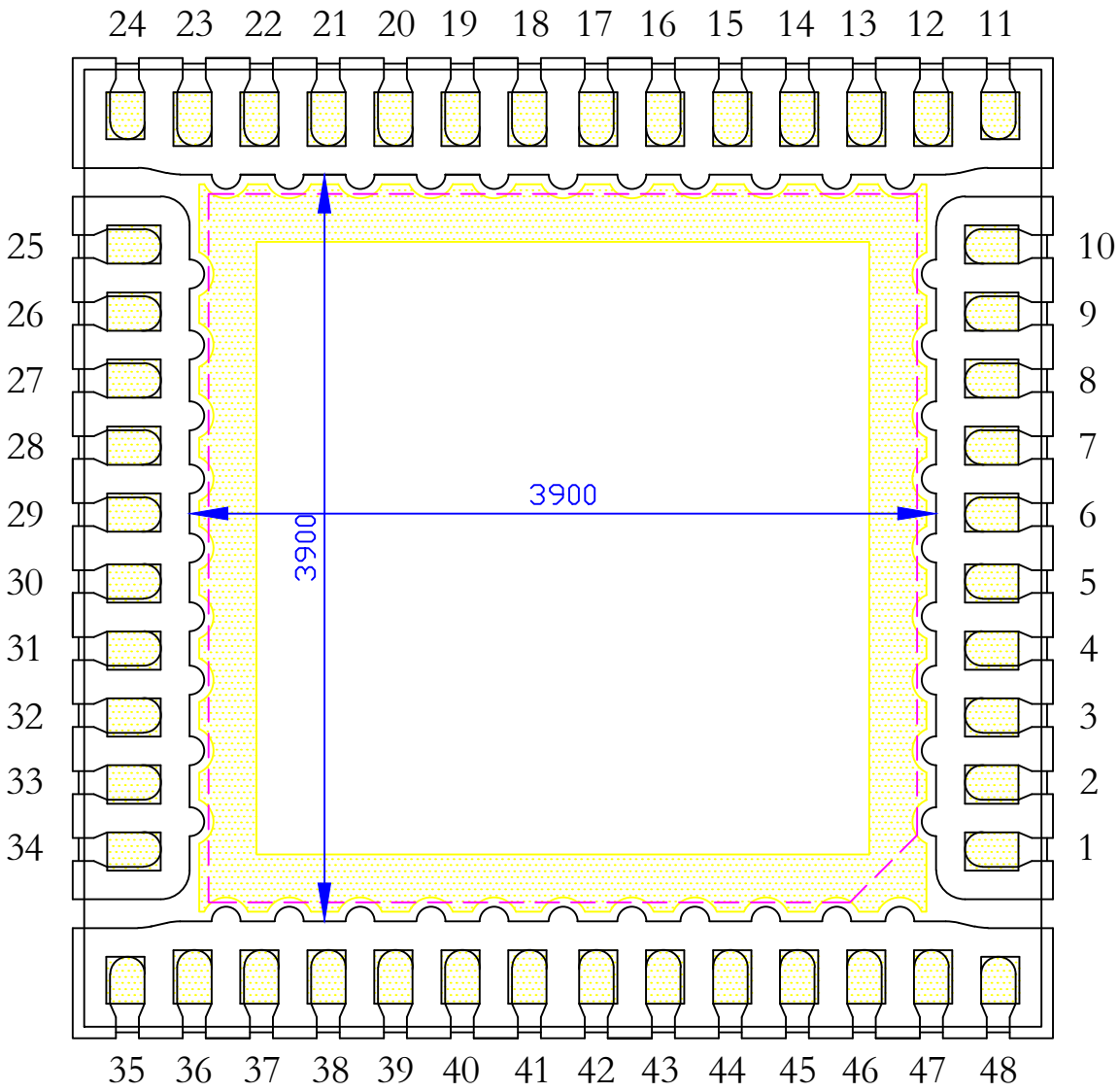


<div><div></div><div><div>池州华宇电子科技股份有限公司</div><div>CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD</div></div></div>				客户代码 Customer No.	0	线图号 Drawing No.	HY-PX-000-000 A	
焊线图纸 Bonding Diagram				产品名称 Product Type	TP9951-FB		封装外型 PKG Type	QFN48L (5×5×0.75-P0.35)
焊线种类 Wire Type	焊线直径(μm) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm) Shortest wire length	塑封料型号(绿色环保) Compound Type (Green)		LF载体尺寸 LF Pad Size
*丝 *	0	0	0	0	0	首选(Preferred): 备选(Optional):		QFN48L(5×5×0.75-P0.35)(154×154mil ²)(1 block) (3900×3900μm ²)
剪刀型号 Capillary Type		*		客户图号 Customer drawing NO.				



框架传送方向 (装片) : L/F Direction (D/A) :		实物图 : Chip photo :	特殊说明 Special Instructions :
<div></div>			DB注意: 芯片居中放置;

说明 Instructions	粘片胶类型 epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BPO (μm ²)	最小焊盘间距 Min BPP(μm)	铝垫厚度(μm) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	划片道宽度 Street line (μm)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否是 Low-K If low-k?	减薄厚度 (μm) Wafer Thickness
A芯: DIE A	导电胶 (conductivity) *	TMNY90A	00*00(μm ²) 00*00(mil ²)	00*00	00	0	是/Yes 否/NO	00	0	是/Yes 否/NO	200
B芯: DIE B	绝缘胶 (Non-conductive) S305D										
C芯: DIE C	绝缘胶(DAF) HR-5104										
制图日期 Create Date		生效日期 Effective Date		客户确认签字/盖章: Customer Signature							
拟制 Prepared by		审核 Checked by									
				批准 Approved by							